

产品描述

MF200是一种单组分、室温固化、有机硅粘合剂。该材料能吸收机械冲击和震动，可用作电子元器件和壳体的粘接。

技术	有机硅胶粘剂
化学类型	单组分有机硅
外观	灰色膏状
固化条件	室温
应用	密封粘接

特点

- 单组分脱醇型
- 施工性能优异
- 对多种基材有优异的粘接性能
- 优异的耐高低温、密封、介电性能

固化条件

表干时间@25°C,50%RH, min	~15min
完全固化@25°C,50%RH, hr	≥24

未固化材料典型特性

特性	特征值
粘度, 平行板流变仪, PP25@10 ⁵ , Pa.s ISO 3219	62
储存期@ 5~30°C, month	6

固化后材料典型特性

特性	特征值
密度, g/cm ³	1.38
硬度, 邵氏 A ASTM D2240	30~40
拉伸强度, MPa GB/T 528	2.0
断裂伸长率, % GB/T 528	400~600
剪切强度, MPa ASTM D1002	≥1.5
介电击穿强度, kv/mm ASTM D149	11
体积电阻率, ohm-cm ASTM D257	1E+13

使用指南

使用前: 需清洁基材表面, 保持被粘物及环境干燥。

应用: 本产品为单组分缩合型硅胶, 使用时可将胶管盖去掉, 头部轻微结皮属正常现象, 可将其去除, 挤出少量头部胶水。胶水可通过人工、半自动、自动化等方式应用, 点胶至样件表面后, 尽快粘接两个被粘面, 置于空气中, 自然室温固化。固化是由表及里的过程, 24h一般可以固化2~4mm深度, 但在接触不到空气的地方固化时间可能延长, 温度降低也会导致固化时间延长。

固化条件: 建议在25°C下固化, 固化条件(时间和温度)可能会根据客户经验、应用要求和客户固化设备而有所不同。客户在实际使用前应考虑使用条件, 并在生产前进行测试。

储存

产品应储存在干燥、未开封的容器中。产品容器标签上有详细的存储信息。

最佳储存温度: 5~30°C。超过此温度范围会对产品性能产生不利影响。从容器中取出的材料可能在使用过程中受到污染。因此, 请勿将产品放回原来的容器中。公司对受污染的产品或在先前规定以外的条件下储存的产品不承担任何责任。如果需要更多信息, 请联系您当地的技术服务中心或客户服务代表。

免责声明

本技术数据表(TDS)中提供的数据基于本公司实验室测试数据的典型值。

TDS中的信息, 包括产品使用和应用的建议, 都基于我们截至本TDS发布之日的产品知识和经验。产品在您的使用中可以有各种不同的应用以及工作条件, 这些应用和工作条件超出了我们的控制范围。因此, 本公司无法保证我们产品适合您使用的生产流程和条件以及预期应用和结果的适用性。我们强烈建议您进行自己的前期试验, 以确认我们产品的合适性。